

High Load Capacity for your empowerment

Mit der optionalen Einheit für hohe Beladefähigkeit beim YXLON Cheetah EVO schließen wir eine Lücke, die die Flexibilität des Mikrofokus-Röntgen- und -CT-Systems enorm erweitert.

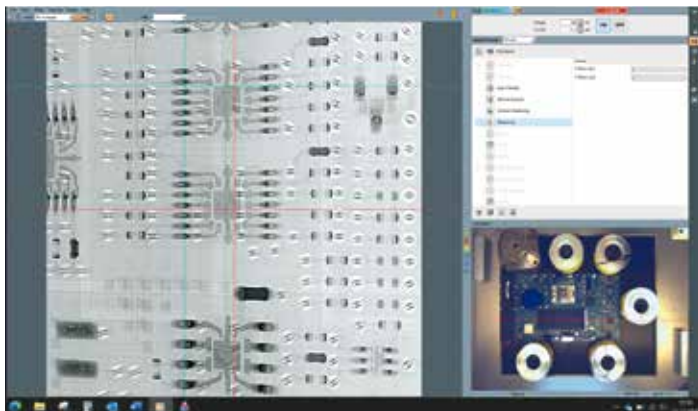
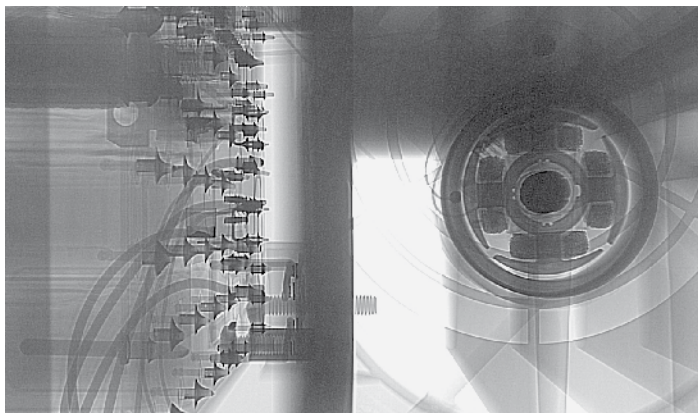
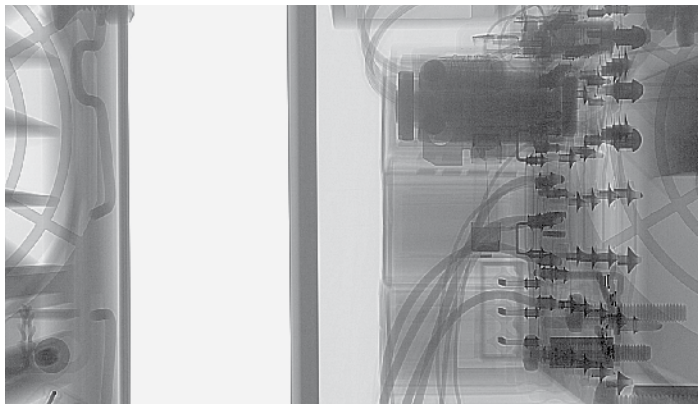
YXLON
Cheetah **EVO**



**20
kg**

High Load
Capacity





Während übliche Qualitätsprüfungen in der fertigen Elektronikindustrie wie SMT üblicherweise mit einer maximalen Beladung des Prüfteilträgers von 2 - 5 kg auskommen, bietet die hohe Belastbarkeit bis zu 20 kg zwei grundlegende Vorteile:

Prüfung von elektronischen Verbindungen in festen Gehäusen

Moderne Fertigung findet immer neue Methoden, um die Effizienz zu steigern. Ob Netzteile oder Steuerkomponenten von E-Fahrzeugen, häufig ist die komplexe Elektronik in fest verschlossenen Gehäusen montiert und muss nachträglich auf ihre Fehlerfreiheit überprüft werden. Mit einem herkömmlichen Tray müssten die Netzteile geöffnet und bei vergossenen Boards Teile der Boards für eine Fehleranalyse herausgeschnitten werden.

Das Beispiel zeigt drei Netzteile, von dem jedes knapp 5 kg Gewicht auf die Waage bringt.

Die Mechanik der optionalen High-Load-Einheit des Cheetah EVO ermöglicht leichtes, gleichmäßiges und präzises Verfahren einer Last von bis zu 20 kg, um kleinste Details selbst im Mikrometerbereich, hier THT-Lötstellen (Through-Hole Technology) im Innern des Aluminiumgehäuses hochauflösend und kontrastreich darzustellen.

Prüfung mehrerer Komponenten gleichzeitig

Jede Röntgenprüfung benötigt Zeit und zusätzliche Zeit für das Be- und Entladen des Prüfteils. Die Prüfung mehrerer Teile gleichzeitig wie im Bild oben rechts reduziert diese Aufwände um ein Vielfaches. In einem Prüfablauf das Innere mehrerer Teile visuell erfassen und manuell analysieren oder die Objekte an einer separaten Auswertestation bequem mittels Software separieren und bewerten, das ist Effizienz auf höchstem Niveau.

YXLON

www.yxlon.com